

株式会社 フェローテック (証券コード:店頭 6890)
Ferrotec Corporation Code-No.6890(JASDAQ)

2007年12月3日
Dec. 3, 2007

目次 Contents

	ページ	Page
1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method		1,2
2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)		3
3. 連結貸借対照表(負債・純資産の部) Consolidated Balance Sheet (Liabilities and Net worth)		4
4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income		5
5. 連結セグメント別売上高・営業利益 Segment Information (Consolidated)		6
6. 期初計画と実績との差異 Review in the first half		7
7. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)		8
8. 期初計画と修正計画との差異(下期) Outline of the revised plan (The second half)		9
9. 期初計画と修正計画との差異(通期) Outline of the revised plan (The accounting period)		10
10. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows		11
11. 主要製品の売上推移 Change in sales of main products (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております/Entry amount cuts less than one million yen and be displaying)		12

本資料は、当社グループの評価を行うための情報提供を目的としたものです。
本資料に記載された数値等は資料作成時点のものであり、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
本資料に基づいた投資等の結果に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

This report is provided solely for the information of professional analysts who are expected to make their own evaluation of the consolidated Subsidiaries.
We don't guarantee the accuracy or completeness of information herein.
Unless otherwise stated, estimates or forecasts are solely those of our company as of the above-mentioned date and subject to change without notice.
We accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report.
This report isn't intended for the use of private investors.

1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method

連結子会社16社 Consolidated Subsidiaries (16)

Subsidiary	Country	Major Products	Capital Stock	Equity Ownership
1. 杭州大和熱磁電子有限公司 HANGZHOU DAHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	真空シール、サーモモジュール、石英 Vacuum Feedthroughs, Thermo-electric Modules, Quartz	228,010千元 228,010thousand RMB	100.0%
2. 杭州和源精密工具有限公司 HANGZHOU WAGEN PRECISION TOOLING CO.,LTD.	中国 China	鋸刃 Saw blade	29,235千元 29,235thousand RMB	100.0%
3. 杭州先進陶瓷材料有限公司 Advanced Ceramic Material (Hangzhou) Co.,Ltd.	中国 China	セラミックス Ceramics	21,523千元 21,523thousand RMB	74.6% (間接所有)
4. 杭州先進石英材料有限公司 Advanced Quartz Material (Hangzhou) Co.,Ltd.	中国 China	石英坩堝 Crucible	13,496千元 13,496thousand RMB	80.0% (40%間接所有)
5. 上海申和熱磁電子有限公司 SHANGHAI SHENHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	サーモモジュール、CMS Thermo-electric Modules, CMS	217,824千元 217,824thousand RMB	100.0%
6. 上海漢虹精密機械有限公司 SHANGHAI HANHONG PRECISION MACHINERY CO.,LTD.	中国 China	工作機械、単結晶引上装置 Machine assemble, Single crystal grower	52,277千元 52,277thousand RMB	100.0%
7. 台湾飛羅特股份有限公司 Ferrotec Taiwan CO.,LTD.	台湾 Taiwan	真空シール Vacuum Feedthroughs	10,000千新台幣 \$ 10,000thousand NT\$	51.0%
8. Ferrotec (USA) Corporation	米国 USA	真空シール、サーモモジュール Vacuum Feedthroughs, Thermo-electric Modules	24,966千ドル \$ 24,966 thousand	100.0%
9. TERMOTEK USA, LLC	米国 USA	その他 Others	100千ドル \$ 100 thousand	60.0% (間接所有)
10. Ferrotec Investments, LLC	米国 USA	その他 Others	350千ドル \$350 thousand	100.0%
11. Ferrotec GmbH	ドイツ Germany	E B -ガン、真空シール、サーモモジュール EB-gun, Vacuum Feedthroughs, Thermo-electric Modules	511千ユーロ 511thousand euro	100.0% (間接所有)
12. FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD.	シンガポール Singapore	真空シール、石英 Vacuum Feedthroughs, Quartz	1,300千シンガポールドル 1,300 thousand Singapore dollar	100.0%
13. S C T B NORD	ロシア Russia	サーモモジュール Thermo-electric Modules	120千ルーブル 120 thousand ruble	95.0%

Subsidiary	Country	Major Products	Capital Stock	Equity Ownership
14. (株)フェロテッククォーツ Ferrotec Quartz Corporation	日本 Japan	石英 Quartz	475百万円 475million yen	100.0%
15. (株)フェロテックシリコン Ferrotec Silicon Corporation	日本 Japan	シリコンインゴット、シリコンウェハ Silicon products, Silicon Wafer	181百万円 181million yen	100.0%
16. アリオンテック(株) ALIONTEK CORPORATION	日本 Japan	石英 Quartz	93百万円 93million yen	44.0%

* アリオンテック(株)は会社法上の子会社ではないが、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める連結子会社。

持分法適用会社 7社 Company Accounted for by the Equity method (7)

持分法適用会社 Company Accounted for by the Equity Method	所在地 Country	主要製品 Major Products	資本金 Capital Stock	出資比率 Equity Ownership
1. 上海博力導国際貿易有限公司 Shanghai Broad International Trading Co.,Ltd.	中国 China	洗浄 cleaning	3,444千元 3,444thousand RMB	60.0%
2. 上海普林客国際貿易有限公司 Shanghai Plating International Trading Co.,Ltd.	中国 China	メッキ Plating	2,265千元 2,265thousand RMB	70.0%
3. 上海庄田国際貿易有限公司 Shanghai Shoda International Trading Co.,Ltd.	中国 China	工作機械 Machine assemble	1,655千元 1,655thousand RMB	50.0% (間接所有)
4. 杭州友好医学検験中心有限公司 Hangzhou Youhao Medical Dianosis Center Co., Ltd.	中国 China	その他 Others	5,000千元 5,000thousand RMB	40.0% (間接所有)
5. SCAN CRUCIBLE AS	ノルウェー Norway	石英坩堝 Crucible	2,463千クローネ 2,463thousand Krone	19.0%
6. 庄田鉄工(株) Shoda Iron Works Co.,Ltd.	日本 Japan	工作機械 Machine assemble	55百万円 55million yen	31.1%
7. Ferrotec Korea Co., Ltd.	韓国 Korea	真空シール Vacuum Feedthroughs	400百万ウォン 400million Korean Won	49.0%

2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)

(単位 百万円、%)

科目	Title of account	07/3		07/9		前期末比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	前期末比 YOY	
流動資産	Current assets	15,961	41.3	18,176	43.5	2,215	13.9	1. 売上債権の増加要因: 比較的上半期後半に売上が増加した為、前期末に比し売掛債権増となった。 2. 主なたな卸資産: 真空シール 1,138百万円 石英 856百万円 シリコンウエーハ 555百万円 3. その他の減少: 未収法人税等の減少による。
現金及び預金	Cash and Deposits	3,225	8.3	4,354	10.4	1,129	35.0	
受取手形・売掛金	Notes and accounts receivable	6,725	17.4	7,462	17.9	737	11.0	
有価証券	Securities	-	-	-	-	-	-	
たな卸資産	Inventories	3,821	9.9	4,605	11.0	784	20.5	
その他	Other assets	2,318	6.0	1,849	4.4	469	20.2	
貸倒引当金	Allowance for doubtful receivables	130	0.3	95	0.2	35	26.9	
固定資産	Fixed assets	22,694	58.7	23,594	56.5	900	4.0	4. 有形固定資産増加の要因: 主に中国子会社でのシリコンウエーハ加工設備の導入により機械装置が増加。
有形固定資産	Tangible fixed assets	16,276	42.1	16,682	39.9	406	2.5	
建物・構築物	Building and Structures	5,497	14.2	5,729	13.7	232	4.2	
機械装置・運搬具	Machinery and Equipment	5,804	15.0	6,743	16.1	939	16.2	
工具器具備品	Tools, furniture and fixtures	1,588	4.1	1,339	3.2	249	15.7	
土地	Land	2,590	6.7	2,595	6.2	5	0.2	
建設仮勘定	Construction in progress	795	2.1	274	0.7	521	65.5	
無形固定資産	Intangible fixed assets	3,474	9.0	3,654	8.7	180	5.2	
のれん	Goodwill	2,532	6.6	2,587	6.2	55	2.2	
その他	Other assets	941	2.4	1,067	2.6	126	13.4	
投資その他の資産	Investments and other assets	2,944	7.6	3,257	7.8	313	10.6	5. 投資有価証券の増加要因: 主に上場株式の時価上昇による。
投資有価証券	Investment securities	1,437	3.7	1,695	4.1	258	18.0	
その他	Other assets	1,560	4.0	1,615	3.9	55	3.5	
貸倒引当金	Allowance for doubtful assets	53	0.1	52	0.1	1	1.9	
資産合計	Total assets	38,656	100.0	41,770	100.0	3,114	8.1	

参考. 換算レート表

	05/9期		06/3期		06/9期		07/3期		07/9期	
	05/6	05/9	05/12	06/3	06/6	06/9	06/12	07/3	07/6	07/9
US\$	110.62	113.19	118.07	117.47	115.24	117.90	119.11	118.05	123.26	115.43
Singapore \$	65.58	66.96	70.89	72.57	72.45	74.32	77.61	77.83	80.40	77.46
RMB	13.31	13.98	14.61	14.64	14.40	14.86	15.24	15.25	16.17	15.36

各期の左側は、子会社の換算レート(子会社は12月決算の為)です。

3. 連結貸借対照表(負債・純資産の部)

Consolidated Balance Sheet (Liabilities and Net worth)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	07/3		07/9		前期末比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	前期末比 YOY	
流動負債	Current liabilities	14,869	38.4	15,999	38.3	1,130	7.6	1. 有利子負債の内容: 短期借入金 + 1年内長期借入・CB 7,881(7,679)百万円 長期借入金 + 社債 4,574(4,508)百万円 合計 12,455(12,188)百万円 *カッコ内は07/3期 単体合計 4,395百万円 (前期末比 101百万円減)
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payables	3,667	9.5	3,882	9.3	215	5.9	
短期借入金	Short-term borrowings	3,771	9.8	3,855	9.2	84	2.2	
1年内返済予定長借入	Current portion of long-term borrowings	2,248	5.8	2,497	6.0	249	11.1	
1年内返済予定転社債	Current portion of Convertible bonds	1,658	4.3	1,528	3.7	130	7.8	
賞与引当金	Accrued corporation taxes	382	1.0	338	0.8	44	11.5	
その他	Other current liabilities	3,139	8.1	3,897	9.3	758	24.1	
固定負債	Long-term liabilities	5,516	14.3	5,749	13.8	233	4.2	
社債	Convertible bonds	-	-	100	0.2	-	-	
長期借入金	Long-term borrowings	4,508	11.7	4,474	10.7	34	0.8	
その他	Other long-term liabilities	1,007	2.6	1,174	2.8	167	16.6	
負債合計	Total Liabilities	20,386	52.7	21,748	52.1	1,362	6.7	2. 流動負債その他の増加要因: 主に引上装置の受注前受金の増加による。
株主資本	Common stock	16,282	42.1	17,109	41.0	827	5.1	
資本金	Common stock	6,910	17.9	6,910	16.5	0	0.0	
資本剰余金	Capital surplus	7,750	20.0	7,712	18.5	38	0.5	
利益剰余金	Profit surplus	2,800	7.2	3,486	8.3	686	24.5	
自己株式	Treasury stock-at cost	1,178	3.0	1,000	2.4	178	15.1	
評価・換算差額等	Valuation adjust.	1,771	4.6	2,691	6.4	920	51.9	
その他有価証券評価差額金	Securities valuation adjust.	448	1.2	607	1.5	159	35.5	
為替換算調整勘定	Cumulative translation adjust.	1,323	3.4	2,083	4.9	760	57.4	
少数株主持分	Minority interests	216	0.6	221	0.5	5	2.3	
純資産合計	Total net worth	18,270	47.3	20,022	47.9	1,752	9.6	9月末、BPS 1,038.15円
負債純資産合計	Total liabilities and Net worth	38,656	100.0	41,770	100.0	3,114	8.1	

* 事業セグメントと製品区分 Business Segments and Product Lines

装置関連	Equipment related	電子デバイス	Electronic device	受託生産	CMS
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	サーモモジュール	Thermo-electric Modules	受託生産	Contract Manufacturing Service
石英製品	Quartz	磁性流体・その他	Ferrofluid & Others		
シリコン製品	Silicon related products	FFB	Fluid film bearing		
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others				

4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	06/9		07/9		前年同期比 HOH	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	14,819	100.0	17,908	100.0	20.8	<p>1. 事業セグメント別の状況</p> <p>(1) 装置関連: 活発な半導体投資と生産増を受けて真空シール・部品及び石英製品が伸長。太陽電池向けでポリシリコン不足はあったもののシリコン製品は半導体向けが安定。</p> <p>(2) 電子デバイス: サーモジュールが、主力の自動車温調シート向けを始め、半導体、バiao、光学、民生向けと広範に拡大、前年同期比32%の増収とセグメント全体の増収を牽引。</p> <p>(3) CMS: Liイオン二次電池関連事業終了の影響で微減収だが、シリコンウェハー加工、装置部品洗浄が堅調に推移。太陽電池向けシリコン単結晶引上装置は、中国セルメーカーから大型受注。</p> <p>2. 売上総利益: 装置関連事業の売上構成比上昇及びCMS事業の収益性向上により売上総利益率が2.9ポイント改善。</p> <p>3. 販管費 売上高増に伴う運賃・旅費交通費の増、内部統制等の準備、監査費用の増により増加。</p> <p>4. 営業外損益 金融費用が増加したものの、為替差益の計上で営業外損益が改善。</p>
売上原価	Cost of sales	10,877	73.4	12,629	70.5	16.1	
売上総利益	Gross profit	3,941	26.6	5,278	29.5	33.9	
販管費	SG&A expenses	2,968	20.0	3,712	20.7	25.1	
営業利益(A)	Operating Income	973	6.6	1,565	8.7	60.9	
営業外収益	Other income	168	1.1	238	1.3	41.7	
受取利息・配当金	Interest & Dividend Income	36	0.2	25	0.1	30.6	
賃貸収入	Lease income	41	0.3	33	0.2	19.5	
為替差益	Foreign exchange gain	-	-	82	-	-	
その他	Other income	90	0.7	96	0.6	6.7	
営業外費用	Other expense	348	2.3	383	2.1	10.1	
支払利息	Interest expense	183	1.2	217	1.2	18.6	
為替差損	Foreign exchange loss	37	-	-	-	-	
持分法投資損失	Equity in loss of investees	8	0.1	47	0.3	487.5	
その他	Other expense	118	0.8	118	0.7	0.0	
経常利益	Recurring income	793	5.4	1,421	7.9	79.1	
特別利益	Extraordinary gain	465	3.1	44	0.3	90.5	
特別損失	Extraordinary loss	237	1.6	142	0.8	40.1	
税前列益	Income before taxes	1,021	6.9	1,323	7.4	29.6	
法人税等	Income tax (current)	357	2.4	421	2.4	17.9	
同 調整額	Income tax (deferred)	20	0.1	12	0.1	40.0	
少数株主利益	Minority interest	21	0.1	1	0.0	-	
当期利益	Net income	663	4.5	913	5.1	37.6	
設備投資	Capital expenditures (CF Base)	1,153		1,329			主に中国子会社でのシリコンウェーハ加工設備更新、石英加工設備の拡充、石英坩堝生産設備導入によるもの。
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	809		1,159			
研究開発費	R&D expenses	93		133			
EBITDA(A+B)	Cash flows	1,782		2,724			
1株利益(円)	EPS(yen)	33.3		43.1			
1株EBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	89.5		142.8			
1株配当金(単独、円)	DPS(yen)	0.0		0.0			
期末従業員数(人)	Number of employees	3,895		4,015			

5. 連結セグメント別売上高・営業利益 Segment Information (Consolidated)

事業別 Operations in Business Segments

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

決算期 Accounting Period		07/3上	07/3下	07/3通期	構成比	前期比	08/3上	前年同期比	08/3下	前年同期比	08/3通期	構成比	前期比
製品 Product Lines		1st Half	2nd Half	Year Ended	Share	YOY	1st Half	YOY	2nd Half	YOY	Year Ended	Share	YOY
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	2,426	3,190	5,616	17.3	29.6	3,017	24.4	2,900	9.1	5,917	16.7	5.4
石英製品	Quartz	2,403	2,903	5,306	16.3	29.9	3,563	48.3	3,200	10.2	6,763	19.1	27.5
シリコン製品	Silicon related products	1,148	1,182	2,330	7.2	51.8	1,377	19.9	1,280	8.3	2,657	7.5	14.0
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	1,093	1,426	2,519	7.7	47.9	1,753	60.4	1,770	24.1	3,523	9.9	39.9
装置関連	Equipment Related	7,070	8,701	15,771	48.5	35.3	9,711	37.4	9,150	5.2	18,860	53.1	19.6
コンピュータシール	Computer Seals	27	4	31	0.1	77.0	-	-	-	-	-	-	-
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	1,862	2,724	4,586	14.1	74.8	2,462	32.2	2,680	1.6	5,142	14.5	12.1
HDD関連 (FFB)	HDD products	18	14	32	0.1	-	15	16.7	30	114.3	45	0.1	40.6
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	328	309	637	2.0	2.0	293	10.7	300	2.9	593	1.7	6.9
電子デバイス	Electronic devices	2,235	3,051	5,286	16.3	55.1	2,769	23.9	3,010	1.3	5,780	16.3	9.3
受託生産	CMS	5,514	5,945	11,459	35.2	29.1	5,427	1.6	5,433	8.6	10,860	30.6	5.2
売上高合計	Total Sales	14,819	17,698	32,517	100.0	35.8	17,908	20.8	17,592	0.6	35,500	100.0	9.2

装置関連	Equipment related	896	1,118	2,014	88.0	76.4	1,155	28.9					
電子デバイス	Electronic devices	12	77	65	2.8	-	99	-					
受託生産	CMS	123	141	264	11.5	43.2	335	172.4					
全社	All	34	21	55	2.4	-	24	-					
営業利益合計	Operating Income	973	1,315	2,288	100.0	89.0	1,565	60.9	1,235	6.1	2,800		22.4

ご参考 営業利益

6. 期初計画と実績との差異 Review in the first half

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	07/9計画 (A)		07/9実績 (B)			コメント
		Original plan		Achievement		計画比	
		金額	前年同期比	金額	前年同期比		
Mil.Yen	YOY	Mil.Yen	YOY				
売上高	Net Sales	16,980	14.6	17,908	20.8	5.5	1. 連結売上高: 半導体の生産増により真空シール及び石英製品の販売が計画を超過。電子デバイスはほぼ計画値。 2. 売上総利益: 装置関連事業及びCMS事業での売上総利益伸長。 3. 販管費: 売上高増加に伴う販売費の増加及び期末換算レートによる金額増。
売上原価	Cost of sales	12,300	13.1	12,629	16.1	2.7	
売上総利益	Gross profit	4,680	18.8	5,278	33.9	12.8	
販管費	SG&A expenses	3,450	16.2	3,712	25.1	7.6	
営業利益	Operating Income	1,230	26.4	1,566	59.9	27.3	
営業外損益	Other income & expense	100	-	145	-	-	
経常利益	Recurring income	1,130	42.5	1,421	78.3	25.8	
特別損益	Extraordinary gain & loss	-	-	98	-	-	
税前列利益	Income before taxes	1,130	10.7	1,323	29.6	17.1	
法人税等	Income tax & others	440	-	410	-	-	
中間当期利益	Net income	690	4.1	913	37.7	32.3	

事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		07/9計画 (A)		07/9実績 (B)			コメント
製品	Product Lines	Original plan		Achievement		計画比	
		金額	前年同期比	金額	前年同期比		
		Mil.Yen	YOY	Mil.Yen	YOY		
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	2,900	19.5	3,017	24.4	4.0	1. 装置関連: 半導体製造装置向け石英製品が米国で好調に推移。 2. 電子デバイス: サーモモジュールが自動車温調シート向けを中心に計画通りに拡大。 3. CMS事業: 引上装置の出荷が一部下期にずれ込み。
石英製品	Quartz	2,800	16.5	3,563	48.3	27.3	
シリコン製品	Silicon products	1,300	13.2	1,377	19.9	5.9	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	1,457	33.3	1,753	60.4	20.3	
装置関連	Equipment related	8,457	19.6	9,711	37.4	14.8	
コンピュータシール	Computer Seals	-	-	-	-	-	
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	2,390	28.4	2,462	32.2	3.0	
HDD関連	HDD products	36	100.0	15	16.7	-	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	318	3.0	293	10.7	7.9	
電子デバイス	Electronic devices	2,744	22.8	2,769	23.9	0.9	
受託生産	CMS	5,779	4.8	5,427	1.6	6.1	
売上高合計	Total Sales	16,980	14.6	17,908	20.8	5.5	

7. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	07/3		08/3e		前期比 YOY	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	32,517	100.0	35,500	100.0	9.2	
売上原価	Cost of sales	23,476	72.2	25,360	71.4	8.0	
売上総利益	Gross profit	9,040	27.8	10,140	28.6	12.2	
販管費	SG&A expenses	6,751	20.8	7,341	20.7	8.7	
営業利益(A)	Operating Income	2,288	6.9	2,800	7.9	22.4	
営業外損益	Other income	207	0.6	400	1.1	-	
経常利益	Recurring income	2,081	6.4	2,400	6.8	15.3	
特別利益	Extraordinary gain	489	1.5	75	0.2	84.7	
特別損失	Extraordinary loss	381	1.2	153	0.4	59.8	
税前利益	Income before taxes	2,189	6.7	2,322	6.5	6.1	
法人税等	Income tax & others	486	1.5	822	2.3	69.1	
当期利益	Net income	1,703	5.2	1,500	4.2	11.9	
設備投資	Capital expenditures (CF Base)	3,263		2,500			
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,807		2,300			
研究開発費	R&D expenses	252		300			
EBITDA(A+B)	Cash flows	4,095		5,100			
1株当り利益(円)	EPS(yen)	86.38		78.64			
1株当りEBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	216.89		267.39			
1株当り配当(単体、円)	DPS(yen)	12.0		12.00			
期末従業員数(人)	Number of employees	4,161		4,100			

* 連単倍率 Consolidated/Non Consolidated ratio

	07/3			08/3e		
	単独(A) Non Consoli.	連結(B) Consoli.	連単倍率 (A)/(B)	単独(A) Non Consoli.	連結(B) Consoli.	連単倍率 (A)/(B)
売上高 Net Sales	15,123	32,517	2.2	18,000	35,500	2.0
営業利益 Operating Income	269	2,288	8.5	200	2,800	14.0
経常利益 Recurring income	662	2,081	3.1	960	2,400	2.5
当期利益 Net income	729	1,703	2.3	480	1,500	3.1

8. 期初計画と修正計画との差異(下期) Outline of the revised plan (The second half)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	08/3下期 期初計画(A) Original plan		08/3下期 修正計画(B) Revised plan			コメント
		金額 Mil.Yen	前年同期比 yoy	金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	計画比 B/A	
売上高	Net Sales	16,520	6.7	17,592	0.6	6.5	下期為替レート: 1ドル = 115円 1. 連結売上高: 足下堅調で期初計画を上回るものの、3Q以降の半導体投資の減速を見込む。 2. 売上総利益: 売上増に伴い増収を見込むが、原材料の値上等懸念有り。 3. 販管費: 売上増に伴い期初計画より増、内部統制等の管理費用も当初計画より増。 4. 経常利益 直近の円高傾向により為替差損の発生を想定。
売上原価	Cost of sales	11,950	84.8	12,731	1.0	6.5	
売上総利益	Gross profit	4,570	79.6	4,861	4.7	6.4	
販管費	SG&A expenses	3,450	8.8	3,628	4.1	5.2	
営業利益	Operating Income	1,120	14.8	1,234	6.2	10.2	
営業外損益	Other income	100	-	255	-	-	
経常利益	Recurring income	1,020	20.8	979	24.0	4.0	
特別損益	Extraordinary gain	-	-	20	-	-	
税前列利益	Income before taxes	1,020	12.7	999	14.5	2.1	
法人税等	Income tax & others	360	-	412	-	-	
当期利益	Net income	660	36.5	587	43.6	11.1	

事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		08/3下期 期初計画(A) Original plan		08/3下期 修正計画(B) Revised plan			コメント
製品	Product type	金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	計画比 B/A	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	2,800	12.2	2,900	9.1	3.6	1. 装置関連: FPD関連製品は回復基調、半導体関連製品は減速を見込む。 2. 電子デバイス: 半導体製造装置向けサーモモジュールの減少を見込む。 3. CMS事業 中国太陽電池セルメーカー向けシリコン単結晶引上装置の受注堅調。
石英製品	Quartz	2,800	3.5	3,200	10.2	14.3	
シリコン製品	Silicon products	1,200	1.5	1,280	8.3	6.7	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	1,417	0.6	1,770	24.1	24.9	
装置関連	Equipment related	8,218	5.6	9,150	5.2	11.3	
コンピュータシール	Computer Seals	0	-	0	-	-	
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	2,760	1.3	2,680	1.6	2.9	
HDD関連	HDD products	39	178.6	30	-	-	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	304	1.6	300	2.9	1.3	
電子デバイス	Electronic devices	3,104	1.7	3,010	1.3	3.0	
受託生産	CMS	5,200	12.5	5,433	8.6	4.5	
売上高合計	Total Sales	16,520	6.7	17,592	0.6	6.5	

9. 期初計画と修正計画との差異(通期) Outline of the revised plan (The accounting period)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen、%)

科目	Title of account	08/3通期 期初計画(A)		08/3通期 修正計画(B)			コメント
		Original plan		Revised plan		計画比 B/A	
		金額 Mil.Yen	前期比 YOY	金額 Mil.Yen	前期比 YOY		
売上高	Net Sales	33,500	3.0	35,500	9.2	6.0	
売上原価	Cost of sales	24,250	3.3	25,360	8.0	4.6	
売上総利益	Gross profit	9,250	2.3	10,140	12.2	9.6	
販管費	SG&A expenses	6,900	2.2	7,341	8.7	6.4	
営業利益(A)	Operating Income	2,350	2.7	2,800	22.4	19.1	
営業外損益	Other income	200	-	400	-	-	
経常利益	Recurring income	2,150	3.3	2,400	15.3	11.6	
特別利益	Extraordinary gain	0	-	75	84.7	-	
特別損失	Extraordinary loss	0	-	153	59.8	-	
税前列益	Income before taxes	2,150	1.8	2,322	6.1	8.0	
法人税等	Income tax & others	800	-	822	69.1	2.8	
当期利益	Net income	1,350	20.7	1,500	11.9	11.1	

事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		08/3通期 期初計画(A)		08/3通期 修正計画(B)			コメント
製品	Product type	Original plan		Revised plan		計画比 B/A	
		金額 Mil.Yen	前期比 YOY	金額 Mil.Yen	前期比 YOY		
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	5,700	1.5	5,917	5.4	3.8	
石英製品	Quartz	5,600	5.5	6,763	27.5	20.8	
シリコン製品	Silicon products	2,500	7.3	2,657	14.0	6.3	
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	2,874	14.1	3,523	39.9	22.6	
装置関連	Equipment related	16,674	5.7	18,860	19.6	13.1	
コンピュータシール	Computer Seals	0	-	0	-	-	
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	5,150	12.3	5,142	12.1	0.2	
HDD関連	HDD Products	75	-	45	-	-	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	622	2.4	593	6.9	4.7	
電子デバイス	Electronic devices	5,847	10.6	5,780	9.3	1.1	
受託生産	CMS	10,979	4.2	10,860	5.2	1.1	
売上高合計	Total Sales	33,500	3.0	35,501	9.2	6.0	

10. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

Activities & Prime Item	06/9	07/3	07/9	コメント
税金等調整前利益 Income before income taxes	1,021	2,189	1,322	
減価償却費 Depreciation and Amortization	809	1,807	1,159	
為替差損益 Net loss or gain on foreign exchange	21	118	124	
売上債権の増減額 Changes in Notes and accounts receivable	1,336	1,529	462	
たな卸資産の増減額 Changes in Inventories	40	214	608	
仕入債務の増減額 Changes in Notes and accounts payable	174	436	67	
その他 Others	504	522	1,330	
. 営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	885	2,049	2,550	
有形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of tangible fixed assets	1,153	3,263	1,329	主な内訳: 杭州子会社 427百万円、上海子会社 600百万円
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of tangible fixed assets	126	87	1	
投資有価証券、有価証券の取得による支出 Payments for purchase of marketable securities and investments in securities	5	139	2	
投資有価証券、有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of marketable securities and investments in securities	633	598	10	
その他 Others	46	52	145	フリーCF 06/9: 532百万円、07/3: 616百万円、07/9: 1,085百万円
. 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	353	2,665	1,465	
短期借入金の増減額 Change in Short-term borrowing	208	400	97	
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term debt	2,253	3,525	1,429	長期借入れの主な実績 フェローテック:1,000百万円 中国子会社:398百万円
長期借入金の返済による支出 Payments of long-term debt	1,715	3,228	1,301	長期借入金の主な返済実績 フェローテック:671百万円 中国子会社467百万円
配当金の支払額 Payments for dividend	158	158	236	
その他 Others	89	1,026	104	
. 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from Financing activities	677	487	101	
. 現金及び現金等価物の中間期末残高 Cash & Cash Equivalent	5,395	3,225	4,354	

11. 主要製品の売上推移 Proceeds change of a main product

(1) 売上高 Net Sales

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

決算期 Accounting Period		01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3	08/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	5,100	3,931	3,208	3,105	4,214	4,335	5,616	5,917
石英製品	Quartz	3,670	3,050	2,293	2,658	4,300	4,086	5,306	6,763
シリコン製品	Silicon products	-	-	-	821	1,100	1,535	2,330	2,657
EB-ガン・その他	EB-Gun&Others	1,503	2,134	1,349	1,338	1,589	1,703	2,519	3,523
装置関連	Manufacturing Eqpt Related	10,273	9,115	6,851	7,921	11,203	11,657	15,771	18,860
コンピュータシール	Computer Seals	2,585	2,209	1,585	1,363	1,012	135	31	-
磁性流体動圧軸受	FFB	-	-	-	-	-	-	32	-
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	1,150	893	1,110	1,577	2,054	2,623	4,586	5,142
HDD関連	HDD products	880	467	332	-	-	-	-	45
磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others	1,547	1,421	1,243	680	512	650	637	593
電子デバイス	Electric devices	6,162	4,990	4,270	3,619	3,578	3,409	5,286	5,780
受託生産	CMS	-	670	1,722	3,458	6,325	8,878	11,459	10,860
売上高合計	Total Sales	16,435	14,775	12,845	15,000	21,105	23,946	32,517	35,500

* 受託生産(CMS)は03/3期から決算短信等で独立表示しております。

(2) 前期比 Growth Rate

(単位 %)

決算期 Accounting Period		01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3	08/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	-	22.9	18.4	3.2	35.7	2.9	29.6	5.4
石英製品	Quartz	-	16.9	24.8	15.9	61.8	5.0	29.9	27.5
シリコン製品	Silicon products	-	-	-	-	-	39.5	51.8	14.0
EB-ガン・その他	EB-Gun&Others	-	42.0	36.8	0.8	18.8	7.2	47.9	39.9
装置関連	Manufacturing Eqpt Related	-	11.3	24.8	15.6	41.4	4.1	35.3	19.6
コンピュータシール	Computer Seals	-	14.5	28.2	14.0	25.8	86.7	77.0	-
磁性流体動圧軸受	FFB	-	-	-	-	-	-	-	-
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	-	22.3	24.3	42.1	30.2	27.7	74.8	12.1
HDD関連	HDD products	-	46.9	28.9	-	-	-	-	-
磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others	-	8.1	12.5	45.3	24.7	27.0	2.0	6.9
電子デバイス	Electric devices	-	19.0	14.4	15.2	1.1	4.7	55.1	9.3
受託生産	CMS	-	-	-	-	82.9	40.4	29.1	5.2
売上高合計	Total Sales	-	10.1	13.1	16.8	40.7	13.5	35.8	9.2

(3) 構成比 Share

(単位 %)

決算期 Accounting Period		01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3	08/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	31.0	26.6	25.0	20.7	20.0	18.1	17.3	16.7
石英製品	Quartz	22.3	20.6	17.9	17.7	20.4	17.1	16.3	19.1
シリコン製品	Silicon products	-	-	-	-	5.2	6.4	7.2	7.5
EB-ガン・その他	EB-Gun&Others	-	-	10.5	8.9	7.5	7.1	7.7	9.9
装置関連	Manufacturing Eqpt Related	62.5	61.7	53.3	52.8	53.1	48.7	48.5	53.1
コンピュータシール	Computer Seals	15.7	15.0	12.3	9.1	4.8	0.6	0.1	-
磁性流体動圧軸受	FFB	-	-	-	-	-	-	0.1	-
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	7.0	6.0	8.6	10.5	9.7	11.0	14.1	14.5
HDD関連	HDD products	5.4	3.2	2.6	-	-	-	-	-
磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others	9.4	9.6	9.7	4.5	2.4	2.7	2.0	1.7
電子デバイス	Electric devices	37.5	33.8	33.2	24.1	17.0	14.2	16.3	16.3
受託生産	CMS	-	-	-	23.1	30.0	37.1	35.2	30.6
売上高合計	Total Sales	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0